



# Status and plans of R&D for Si-detectors on BM@N

## N. Zamyatin on behalf of Forward Silicon Detector team

13<sup>th</sup> Collaboration Meeting of BM@N experiment, 8-10 October 2024

# **R&D for Si-detectors on BM@N**

# **1.** Design of new Si-station #5 for FSD:

- two planes with 11pcs of Si-modules;
- active area of Si-modules (186×63)mm<sup>2</sup>;
- Number of FEE-channels (strips) of station 128×10×22=28 160 ch;
- Contract # 100-03046 (26.07.2024), ZNTC-JINR for production 50 pcs of DSSD and 60 pcs of PA-640.

# **2. Design of ASIC-128 ch chip** (ASi-BM@N) for FEE station#5 FSD:

- design and simulation of chip (2022-2023 years);

- GDS files for production experimental chips;

- Contract # 100-03185 (06.08.2024), INP BSU (Minsk) - JINR for production 3 wafers/2000 chips – in 2024-2025 years;

**3. Design of new beam profilometer** for heavy ions Xe(10.8 pC/175  $\mu$ m-Si), Au (20.9 pC/175  $\mu$ m-Si), Bi) with high dynamic range of  $\Delta$ E-signals (240÷500 MeV/175  $\mu$ m-Si).

4. Experimental measurements of neutrons equivalent fluence (1 MeV) in FSD region (on outer surface beam-pipe and in region FEE-chips)

## 1. Position of the new FSD-station #5 on the BM@N



# X-Z cross section of central tracker

![](_page_3_Figure_1.jpeg)

# Three type of Si-modules for Forward Si detector

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

![](_page_4_Figure_2.jpeg)

Detectors size:  $63x93x0,3 \text{ mm}^3$  (on 6" – FZ-Si-n wafers) Topology: double sided microstrip (DSSD) (DC coupling) Pitch p<sup>+</sup> strips: 95 µm; Pitch n<sup>+</sup> strips 107,1 µm; Stereo angle between p<sup>+</sup>/n<sup>+</sup> strips: 2.5<sup>0</sup> Number of strips/DSSD: 640 (p<sup>+</sup>)×603(n<sup>+</sup>) Number of strips/module: 640 (p<sup>+</sup>)×640(n<sup>+</sup>) Detectors size: 63x63x0,3 mm<sup>3</sup> (on 4" – FZ-Si-n wafers) Topology: double sided microstrip (DSSD) (DC coupling) Pitch p<sup>+</sup> strips: 95 μm; Pitch n<sup>+</sup> strips 103 μm; Stereo angle between p<sup>+</sup>/n<sup>+</sup> strips: 2.5<sup>0</sup> Number of strips/DSSD: 640 (p<sup>+</sup>)×614(n<sup>+</sup>) Number of strips/module: 640 (p<sup>+</sup>)×640(n<sup>+</sup>)

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

### 2. Main parameters and block scheme of ASIC-128 ch/ASi-BM@N

Параметры детектора					
Тип детектора	Кремниевый, стриповый,				
	двухсторонний				
Толщина кремниевого детектора	(200÷500) мкм				
Сигнал детектора, m.i.p.	4 фКл/300 мкм				
Напряжение смещения, В	До 100 В				
Емкость стрипа, пФ	20÷100				
Параметры ИС					
Технология	СМОЅ, 180нм				
Количество каналов	128				
Напряжение питания, В	1.8 (однополярное)				
Ток потребления аналоговых	115				
блоков, мА	115				
Ток потребления цифровых блоков,	12				
мА	12				
Рассеиваемая мощность, мВт	229				
	ЗЧУ+Формирователь+СВХ+Мультип				
	лексор				
Защита по входам	Контактные площадки с защитными				
защита по входам	диодами				
Компенсация токов утечки	До 5 нА, автоматическая,				
······································	отключаемая				
	Нечетных и четных через				
Тестирование	встроенные конденсаторы				
	ёмкостью 0.05 пФ				
Тестовый канал	Контроль формы и амплитуды				
	выходного				
Время формирования, нс	300 и 200				
Порядок формирователя	4				
Линейный диапазон входных	+/-30				
зарядов, фК	,				
Коэффициент преобразования	20				
аналогового выхода, мкА/фКл					
ENC (r.m.s.), e	215е+11.6 е/пФ				
Мультиплексор	128:1				
Частота чтения данных, МГц	20				
Выход мультиплексора	Токовый, дифференциальный				
Цифровые сигналы управления	LVDS				

![](_page_5_Figure_2.jpeg)

Переключатели:

1) Время формирования: «1» - 300 нс, «0» - 200 нс

2) Полярность сигнала: «1» - минус , «0» - плюс

3) Автоматическая компенсация токов утечки: «1» - включение

4) Автоматическая фиксация постоянного уровня формирователя: «1» - включение

#### 3. New beam profilometer for heavy ions (Xe, Au, Bi) with Si-detector (64×64) strips

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

Beam profilometer inside beam vacuum station

![](_page_6_Picture_5.jpeg)

Beam profilometer standalone DAQ

New readout electronics for beam profilometer

#### **Beam profilometer** is necessary for beam tuning in self trigger mode (alignment of the center beam with the center of the target)

- **detector:** DSSD,  $(128p^+ \times 128n^+)$ , strips pitch = 475 µm, thickness (Si) -175 µm, active area (61 × 61) mm<sup>2</sup>. Strips are combined in pairs on detector board. Total have  $(64p^+ \times 64n^+)$ , pitch = 950 µm
- **mechanical design:** the plane of the profilometer is automatically removed from the beam zone to the parking position
- FEE based on two VA32HDR11 ASICs. Total number of channels are 64 for X and 64 for Y coordinate. Dynamic range of signals:  $-35pC \div$ +25pC. Charge of ionization for heavy ions Xe(10.8 pC/175 µm-Si), Au (20.9 pC/175 µm-Si), Bi) corresponded of  $\Delta$ E-signals (240÷500 MeV/175 µm-Si).

Peaking time 800 ns.

Self trigger mode based on TA32cg2 ASICs

• current status:

FEE have been designed, manufactured, work in progress to electronics tests.

Next step is testing FEE with Si detector placed in flanges with alpha-source (5.5 MeV) and standalone DAQ subsystem.

# 4. Radiation Si-monitors on FSD region for equivalent neutron fluence measurement

- Si- pin-detector (rad\_monitor) :
- Detectors size: (5×5×0,3) mm<sup>3</sup>
- Detectors thickness: 300 µm
- Active area: 13 mm<sup>2</sup>

 $\Delta I = \alpha_I \times V \times \Phi$ 

- $\Delta \mathbf{I} = \mathbf{I}_{\phi} \mathbf{I}_{0}, \ (\mathbf{A}):$
- $I_{\phi}$  dark current after irradiation;
- **I**<sub>0</sub> dark current before irradiation;
- $\alpha_{I} = (5\pm0,5)\cdot10^{-17} (A\times cm^{-1})$ - radiation damage constant-Si (for neutrons 1MeV at +20°);
- V, (cm<sup>3</sup>) volume of SCR (spice charge region at U<sub>fd</sub>);
- Φ, (cm<sup>-2</sup>) eq. neutron fluence (1 MeV)

![](_page_7_Figure_12.jpeg)

Приложение-1: (девять следующих слайдов)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

#### FSD: after replacing

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

![](_page_9_Figure_3.jpeg)

E.V. Martovitsky; D.D. Chemezov

![](_page_10_Figure_0.jpeg)

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

#### **FEE board replacing**

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

![](_page_11_Figure_3.jpeg)

![](_page_11_Figure_4.jpeg)

Yu.A. Kopylov; O.G. Tarasov

![](_page_11_Picture_6.jpeg)

To eliminate the dead zones it was necessary to assemble a new FEE board completely, 5 ASICs were spent to eliminate each of defects. The old boards were disconnected from the modules and replaced with a new ones. Total: 9 new black boards (p+ strips) were built, 45 VATAGP 7.2 ASICs were used (30 spare ASICs available).

# Y-Z cross section of central tracker

# GEM tracking system

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

# Position of double-coordinate Si-detectors relative to the axis of the ion guide

![](_page_13_Figure_1.jpeg)

Beam directions

![](_page_13_Figure_3.jpeg)

\*Distance between the flange surface and the detector surface. Detector rotation in the coordinate plane no more than 0.5<sup>o</sup>

Beam tracker detector center coordinates relative to the ion guide axis (mm)

#	Х	Y	Z*
#1	0.0	0.9	94.7
#2	2.7	-0.3	96.9
#3 (AI)	0.4	0.1	94.9

Strip pitch in the detector: 0.45 mm Number of strips: 128x128 Thickness: 175 μm Size: 63 x 63 mm<sup>2</sup>

# Beam profilometer detector center coordinates relative to the ion guide axis (mm)

#	х	Y	Z*
#1 (electric)	-1.3±0.1	0.7±0.1	99.7
#2 (pneumatic)	-2.7±0.5	1.4±0.2	100.7

Strip pitch in the detector: 1.87 mm Number of strips : 32x32 Thickness: 175  $\mu$ m Size: 60 x 60 mm<sup>2</sup>

### New beam profilometer (64×64) strips for heavy ions (Xe, Au, Bi)

На рис. результаты тестов-2022 с альфа источником Si – профилометра: - такую же картину мы хотели получить при работе с пучком, но не удалось из-за наложений при «медленной» электронике (ИС-VA163);

 оба профилометра были убраны в положение «парковка» и не использовались в сеансе;
наши планы и действия – ведется новая разработка (С.Хабаров+О.Тарасов) конструкции плоскости детектора (128х128) стрипов превращаем в (64х64) стрипа + новая FEE на основе ИС HDR64/VA, чипы есть в наличии, детекторные платы разработаны, изготовлены и готовы к сборке детекторов, FEE-PCB в разработке (С.Хабаров), детекторы есть и тестируются (Е.Стрелецкая+Ю.Копылов), готовность – осень\_23.

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

- detector: DSSD, (32p<sup>+</sup>×32n<sup>+</sup>), strips pitch = 1.8 mm, thickness (Si) -175 μm, active area (60 × 60) mm<sup>2</sup>;
- **mechanical design:** the plane of the profilometer is automatically removed from the beam zone to the parking position;
- FEE: for light (<sub>6</sub>C ÷ <sub>18</sub>Ar) ions based on VA163 + TA32cg2 (32 ch, dynamic range (DR): -750fC ÷ +750fC) desing in progress;
- current status:

- two vacuum stations with flanges and cable connectors are ready, Silicon Detectors assembled on PCBs and tested with alpha-source (5.5 MeV), autonomus (ADC+DAQ) subsystem ready;

- for heavy (Kr  $\div$  Au) ions will be developed another version of the FEE with DR =  $\pm 20$  pC.

![](_page_15_Figure_0.jpeg)

Токи детекторов BT(1÷3) в начале сеанса и по окончании сеанса:

- «подложка» это темновой ток, создаваемый радиационными дефектами ионов Хе;
- быстрая импульсная компонента это ток ионизации в течение спилов.

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

![](_page_16_Figure_1.jpeg)

Рис.5. Схема измерений (а) темнового тока двухстороннего стрипового Siдетектора и ВАХ (б) до и после сеанса.

Формула определения эквивалентного 1МэВ флюенса нейтронов по повреждениям кремния  $\Delta I = \alpha_1 \cdot \Phi \cdot V$ где:  $\alpha_1$  – токовая константа повреждений кремния равняется 5×10<sup>-17</sup> A/см, при +20°C для нейтронов с энергией 1 МэВ и физически означает приращение тока в кремниевом детекторе объемом 1см<sup>3</sup> от прохождения одного нейтрона (1 МэВ),  $\Phi$ ,см<sup>-2</sup> – флюенс нейтронов, V, см<sup>3</sup> – объем детектора.

LHEP		1		BM@N
ЛФВЭ	I <sub>d0</sub> , мкА/+20 B/+22.5°C	l <sub>d(ф)</sub> , мкА/+20 B/+26.8°C		$\Delta I = Id(\varphi) - Id0 = \alpha I \cdot \varphi \cdot V,$
	(04.12.2022 начало сеанса)	(2.02.2023 окончание сеанса)		мка (приведённое к +20 °C)
BT1	0.965	12.7		4.76
BT2	0.692	12.5		4.6
BT3	0.626	12.9		4.93
	Эквивалентный флк нейтронов 1 МэВ, с (измерен по радиацио повреждениям Si)	Dенс :M <sup>-2</sup> нным	Флюенс <sup>128</sup> Хе, см <sup>-</sup> расчет через NIEL <i>К(<sup>128</sup>Хе/нейтрон</i> 1МэВ)=276	<sup>2</sup> Число ядер <sup>128</sup> Хе, прошедших за сеанс через Si-детекторы BT(1÷3), S <sub>a</sub> =37 см <sup>2</sup>
BT1	5.117e+12		1.854e+10	6.899e+11
BT2	4.945e+12		1.792e+10	6.667e+11
BT3	5.300e+12 1.92		1.920e+10	<b>7.145e+11</b>
<b>6</b>				